特点

- 3.0V~5.5V 宽电源范围，半双工；
- 总线端口 ESD 保护能力 HBM 达到 15kV 以上；
- 总线容错耐压达到±15V；
- 1/8 单位负载，允许最多 256 个器件连接到总线；
- 驱动器短路输出保护；
- 低功耗关断功能；
- 接收器开路失效保护；
- 具有较强的抗噪能力；
- 集成的瞬变电压抵制功能；
- 在电噪声环境中的数据传输速率可达到 14Mbps；
- 提供 SOP，DIP8，小外型 DFN3*3-8，MSOP8 封装。

产品外形示意图



提供绿色环保无铅封装

描述

SIT3088E 是一款 3.0V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 保护能力 HBM 达到 15kV 以上、总线耐压范围达到±15V、半双工、低功耗，功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。

SIT3088E 包括一个驱动器和一个接收器，两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时，驱动器与接收器均输出高阻态。SIT3088E 具有 1/8 负载，允许 256 个 SIT3088E 收发器并接在同一通信总线上。可实现高达 14Mbps 的无差错数据传输。

SIT3088E 工作电压范围为 3.0~5.5 V，具备失效安全（fail-safe）、限流保护、过压保护等功能。

引脚分布图

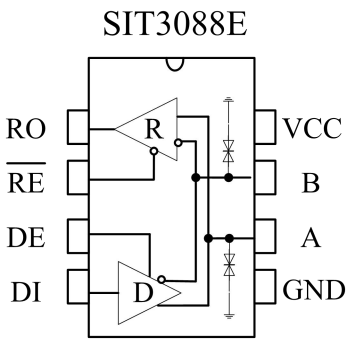


图 1 SIT3088E 引脚分布图

引脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	RO	接收器输出端。 当/RE 为低电平时，若 A-B≥-10mV，RO 输出为高电平； 若 A-B≤-200mV，RO 输出为低电平。
2	/RE	接收器输出使能控制。 当/RE 接低电平时，接收器输出使能，RO 输出有效；当/RE 接高电平时，接收器输出禁能，RO 为高阻态； /RE 接高电平且 DE 接低电平时，器件进入低功耗关断模式。
3	DE	驱动器输出使能控制。 DE 接高电平时驱动器输出有效，DE 为低电平时输出为高阻态； /RE 接高电平且 DE 接低电平时，器件进入低功耗关断模式。
4	DI	DI 驱动器输入。DE 为高电平时， DI 上的低电平使驱动器同相端 A 输出为低电平，驱动器反相端 B 输出为高电平； DI 上的高电平将使同相端输出为高电平，反相端输出为低。
5	GND	接地。
6	A	接收器同相输入和驱动器同相输出端。
7	B	接收器反相输入和驱动器反相输出端。
8	VCC	接电源。

极限参数

参数	符号	大小	单位
电源电压	VCC	+6.5	V
控制端口电压	/RE，DE，DI	-0.3~VCC+0.5	V
总线侧输入电压	A，B	-15~+15	V
接收器输出电压	RO	-0.3~VCC+0.5	V
工作温度范围	T_A	-40~125	℃
存储工作温度范围	T_{stg}	-60~150	℃
焊接温度范围		300	℃

最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的，器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性，所有的电压的参考点为地。

驱动器直流电学特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
驱动器差分输出（无负载）	V_{OD1}		3		5.5	V
驱动差分输出	V_{OD2}	图 2，RL = 54 Ω，VCC=3.3V	1.5		VCC	V
		图 2，RL = 54 Ω，VCC=5V	1.5		VCC	
输出电压幅值的变化（NOTE1）	ΔV_{OD}	图 2，RL = 54 Ω			0.2	V
输出共模电压	V_{OC}	图 2，RL = 54 Ω			3	V
共模输出电压幅值的变化（NOTE1）	ΔV_{OC}	图 2，RL = 54 Ω			0.2	V
高电平输入	V_{IH}	DE，DI，/RE	2.0			V
低电平输入	V_{IL}	DE，DI，/RE			0.8	V
逻辑输入电流	I_{IN1}	DE，DI，/RE	-2		2	μA
输出短路时的电流，短路到高	I_{OSD1}	短路到 0V~12V			250	mA
输出短路时的电流，短路到低	I_{OSD2}	短路到-7V~0V	-250			mA

（如无另外说明，Temp=T_{MIN}~T_{MAX}，Temp=25℃）。

NOTE1：ΔV_{OD} 和ΔV_{OC} 分别是输入信号 DI 状态变化时引起的 V_{OD} 与 V_{OC} 幅值的变化。

接收器直流电学特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入电流（A，B）	I_{IN2}	DE = 0 V，VCC=0 或 3.3/5V V_{IN} = 12 V			125	μA
		DE = 0 V，VCC=0 或 3.3/5V V_{IN} = -7 V	-100			μA
正向输入阈值电压	V_{IT+}	-7V≤V_{CM}≤12V			-10	mV
反向输入阈值电压	V_{IT-}	-7V≤V_{CM}≤12V	-200			mV

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入迟滞电压	V_{hys}	-7V≤V_{CM}≤12V	10	30		mV
高电平输出电压	V_{OH}	I_{OUT} = -2.5mA， V_{ID} = +200 mV	VCC-1.5			V
低电平输出电压	V_{OL}	I_{OUT} = +2.5mA， V_{ID} = -200 mV			0.4	V
三态输入漏电流	I_{OZR}	0.4V<V_O<2.4V			±1	μA
接收端输入电阻	R_{IN}	-7V≤V_{CM}≤12V	96			kΩ
接收器短路电流	I_{OSR}	0V≤V_O≤VCC	±8		±90	mA

（如无另外说明，Temp=T_{MIN}~T_{MAX}，Temp=25℃）。

供电电流

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
供电电流	I_{CC1}	/RE=DE = 0V， VCC=3.3V		240	650	μA
		/RE=DE = 0V， VCC=5V		270	750	μA
	I_{CC2}	/RE=DE=VCC， VCC=3.3V		250	650	μA
		/RE=DE=VCC， VCC=5V		280	750	μA
关断电流	I_{SHDN}	/RE=VCC，DE=0V， VCC=3.3V		0.2	10	μA
		/RE=VCC，DE=0V， VCC=5V		0.2	10	μA

驱动器开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
驱动器差分输出延迟	t_{DD}	R_L = 60Ω，C_L =100pF（见图 3 与图 4）		20	40	ns
驱动器差分输出过渡时间	t_{TD}			12	28	ns
驱动器传播延迟从低到高	t_{PLH}	R_L = 27Ω（见图 3 与图 4）		20	40	ns
驱动器传播延迟从高到低	t_{PHL}			20	40	ns
$\|t_{PLH}-t_{PHL}\|$	t_{PDS}			1	8	ns
使能到输出高	t_{PZH}	R_L = 110Ω（见图 5 与图 6）			55	ns
使能到输出低	t_{PZL}				55	ns
输入低到禁能	t_{PLZ}	R_L = 110Ω（见图 5 与图 6）			85	ns
输入高到禁能	t_{PHZ}				85	ns
关断条件下，使能到输出高	t_{DSH}	R_L = 110Ω（见图 5 与图 6）		20	100	ns
关断条件下，使能到输出低	t_{DSL}	R_L = 110Ω，（见图 5 与图 6）		20	100	ns

接收器开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
接收器输入到输出传播延迟从低到高	t_{RPLH}	C_L=15pF 见图 7 与图 8		60		ns
接收器输入到输出传播延迟从高到低	t_{RPHL}			60		ns
$\|t_{RPLH} - t_{RPHL}\|$	t_{RPDS}			3	10	ns
使能到输出低时间	t_{RPZL}	C_L=15pF 见图 7 与图 8		15	40	ns
使能到输出高时间	t_{RPZH}	C_L=15pF 见图 7 与图 8		15	40	ns

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
从输出低到禁能时间	t_{RPLZ}	C_L=15pF 见图 7 与图 8		25	55	ns
从输出高到禁能时间	t_{RPHZ}	C_L=15pF 见图 7 与图 8		25	55	ns
关断状态下使能到输出高时间	t_{RPSH}	C_L=15pF 见图 7 与图 8		150	500	ns
关断状态下使能到输出低时间	t_{RPSL}	C_L=15pF 见图 7 与图 8		150	500	ns
进入关断状态时间	t_{SHDN}	NOTE2	50		300	ns

NOTE2：当/RE=1，DE=0 持续时间小于 50ns 时，器件必不进入 shutdown 状态，当大于 300ns 时，必定进入 shutdown 状态。

功能表

发送功能表

控制		输入	输出	
/RE	DE	DI	A	B
X	1	1	H	L
X	1	0	L	H
0	0	X	Z	Z
1	0	X	Z(shutdown)	
X：任意电平；Z：高阻。				

接收功能表

控制		输入	输出
/RE	DE	A-B	RO
0	X	≥-10mV	H
0	X	≤-200mV	L
0	X	开/短路	H
1	X	X	Z
X：任意电平；Z：高阻。			

测试电路

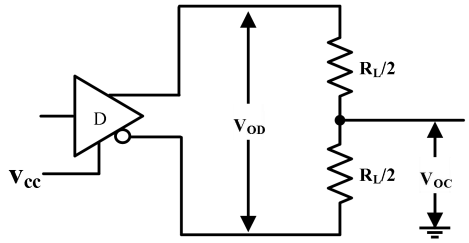
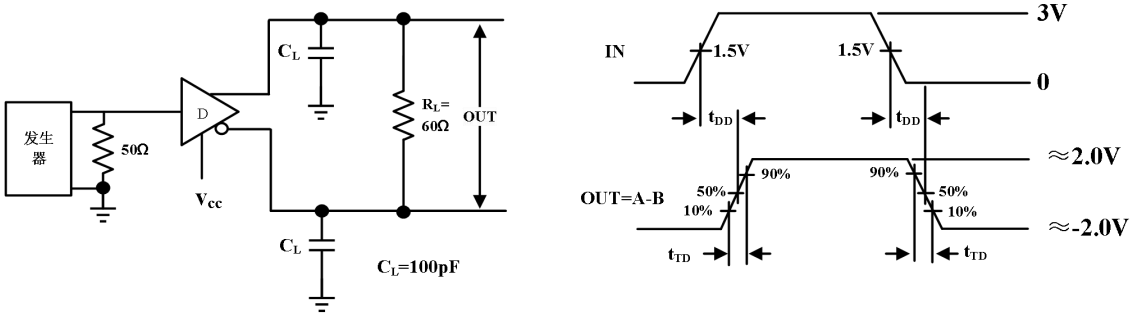


图 2 驱动器直流测试负载



CL 包含探针以及杂散电容（下同）。

图 3 驱动器差分延迟与渡越时间

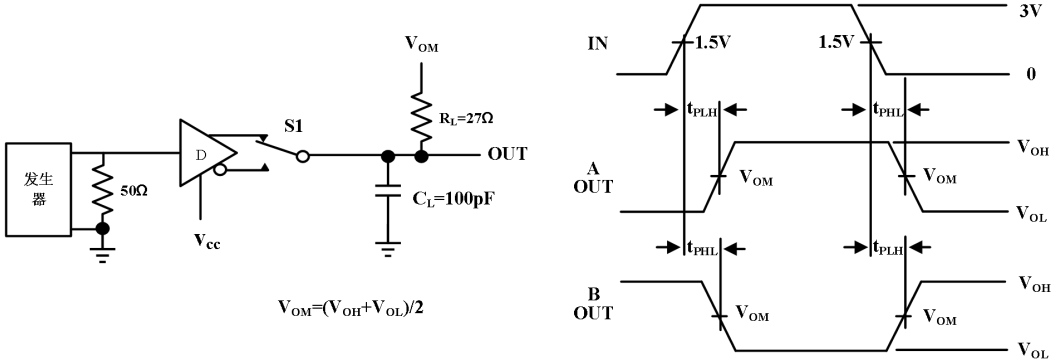


图 4 驱动器传播延迟

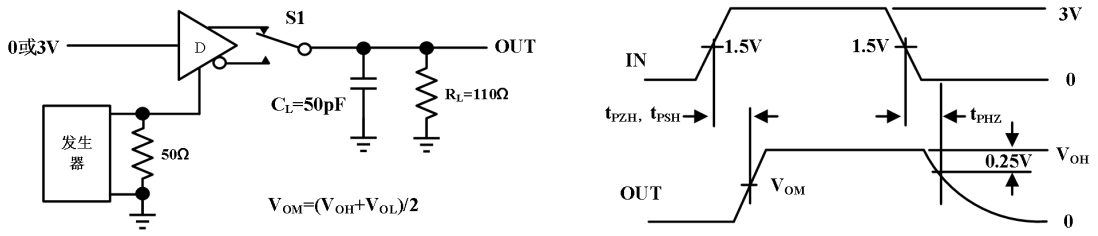


图 5 驱动器使能与禁能时间

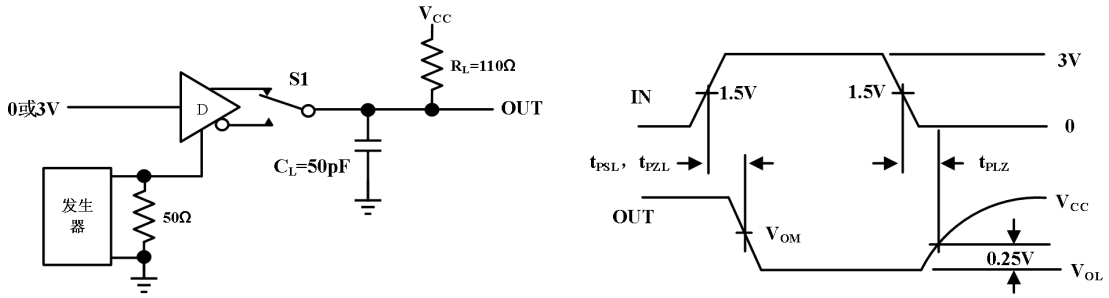


图 6 驱动器使能与禁能时间

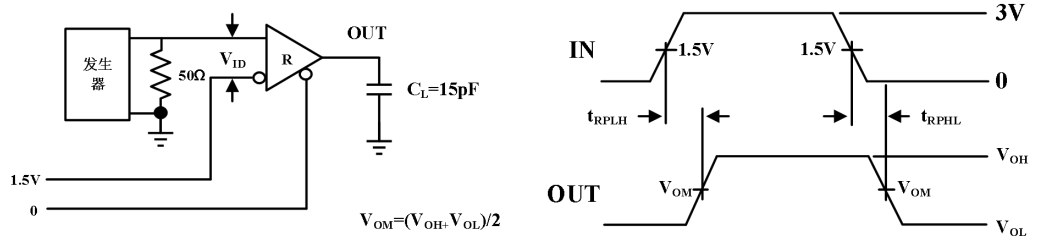
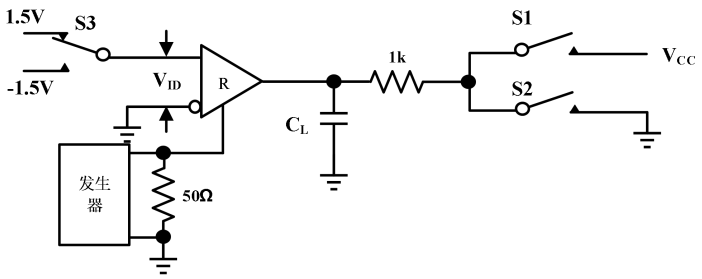


图 7 接收器传播延时测试电路



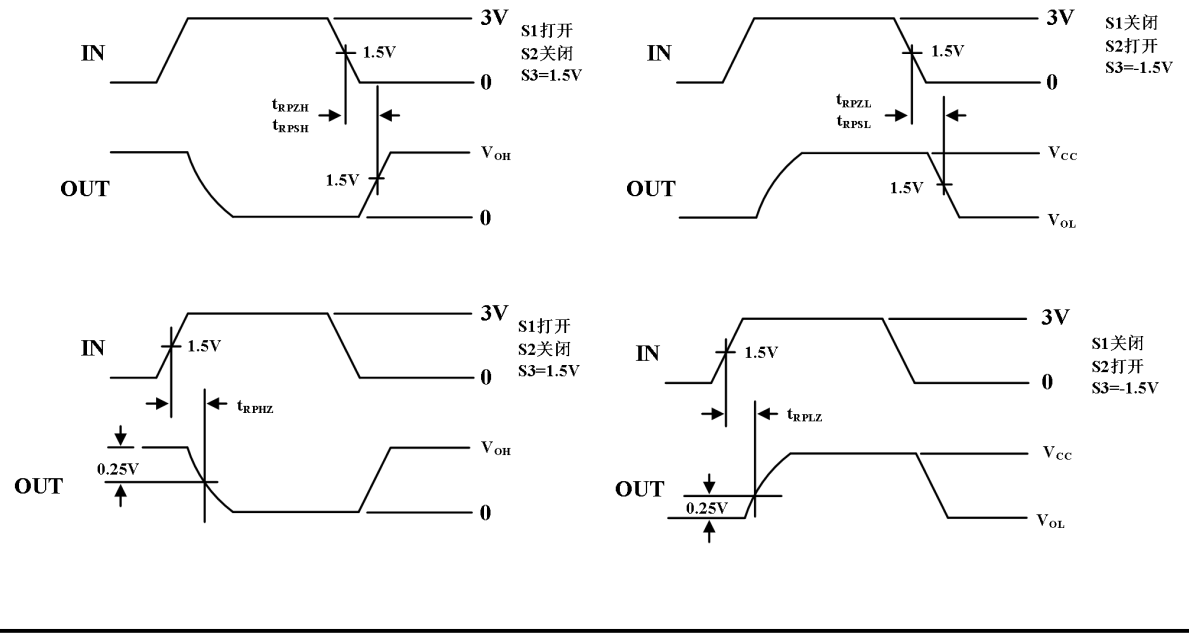


图 8 接收器使能与禁能时间

说明

1 简述

SIT3088E 是一款 3.0V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 保护能力 HBM 达到 15kV 以上、总线直流耐压达到±15V 以上、用于 RS-485/RS-422 通信的半双工高速收发器，包含一个驱动器和接收器。具有失效安全，过压保护、过流保护功能。SIT3088E 实现高达 14Mbps 的无差错数据传输。

2 总线上挂接 256 个收发器

标准 RS485 接收器的输入阻抗为 12kΩ（1 个单位负载），标准驱动器可最多驱动 32 个单位负载。SIT3088E 收发器的接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗（96kΩ），允许最多 256 个收发器并行挂接在同一通信总线上。这些器件可任意组合，或者与其它 RS485 收发器进行组合，只要总负载不超过 32 个单位负载，都可以挂接在同一总线上。

3 驱动器输出保护

过流保护，在整个共模电压范围（参考典型工作特性）内提供快速短路保护，避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。

4 典型应用

4.1 总线式组网：SIT3088E RS485 收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 9 显示了典型网络应用电路。这些器件也能用作电缆长于 4000 英尺的线性转发器，为减小反射，应当在传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配，主干线以外的分支连线长度应尽可能短。

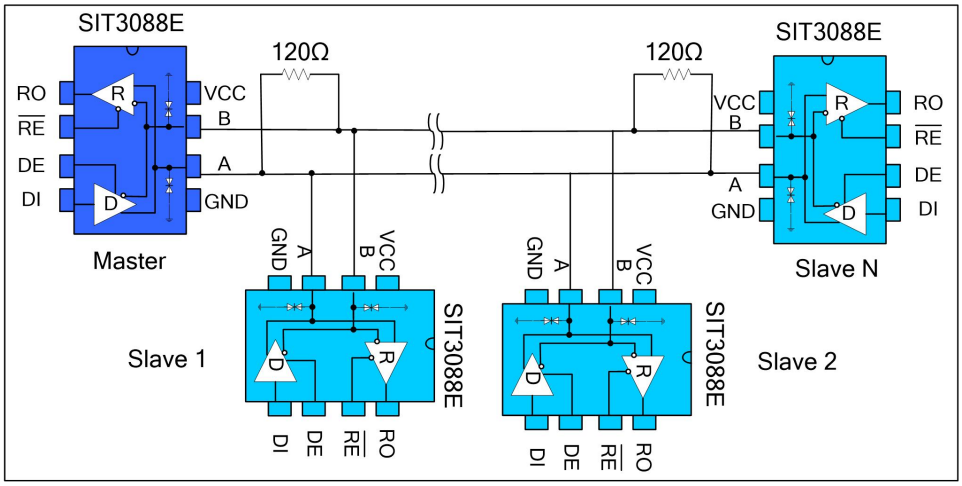


图 9 总线式 RS485 半双工通讯网络

4.2 手拉手式组网：又称菊花链拓扑结构，是 RS485 总线布线的标准及规范，是 TIA 等组织推荐使用的 RS485 总线拓扑结构。其布线方式就是主控设备与多个从控设备形成手拉手连接方式，如图 10 所示，不留分支才是手拉手的方式。这种布线方式，具有信号反射小，通讯成功率高等优点。

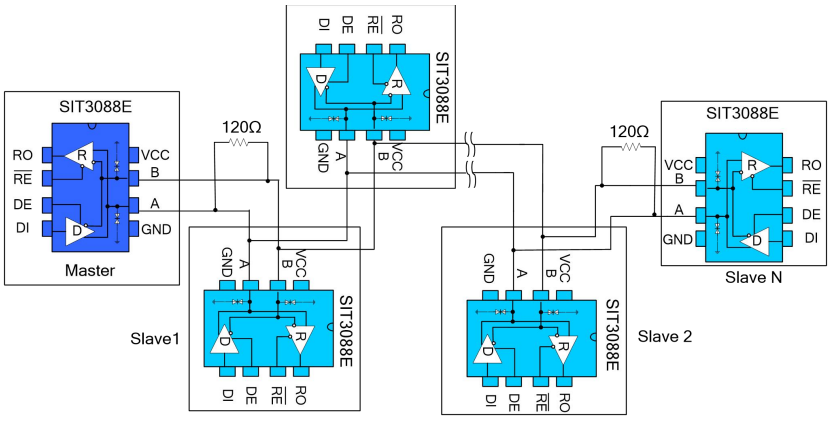


图 10 手拉手式 RS485 半双工通讯网络

4.3 总线端口防护：在恶劣的环境下，RS485 通讯端口通常都做好静电防护、雷击浪涌防护等额外的防护，甚至还需要做好防止 380V 市电接入的方案，以避免智能仪表、工控主机的损坏。图 11 为常见的 3 种 RS485 总线端口防护方案。第一种为 AB 端口分别并联 TVS 器件到保护地，AB 端口之间并联 TVS 器件、AB 端口分别串联热敏电阻、并接气体放电管到保护地形成三级保护的方案；第二种为 AB 分别并联 TVS 到地、串联热敏电阻，AB 之间并联压敏电阻的三级防护方案；第三种为 AB 分别接上下拉电阻到电源与地，AB 之间接 TVS，A 或 B 某一端口接热敏电阻的方案。

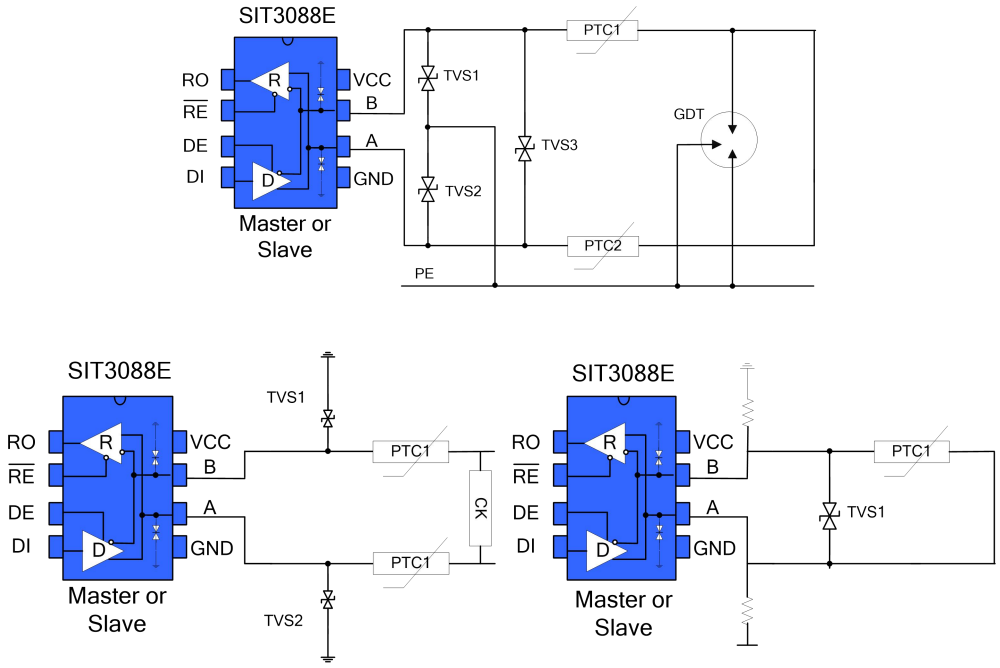
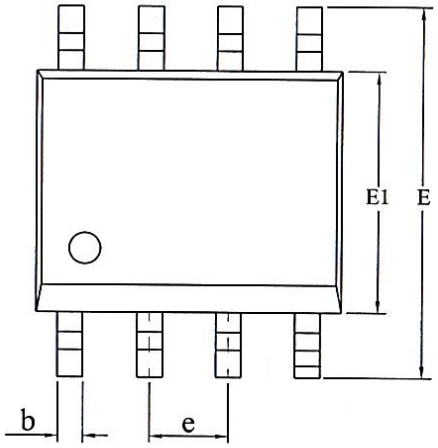


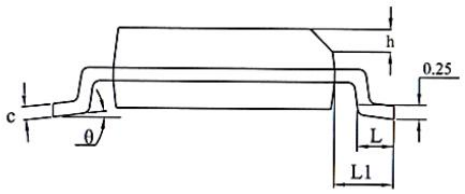
图 11 端口防护方案

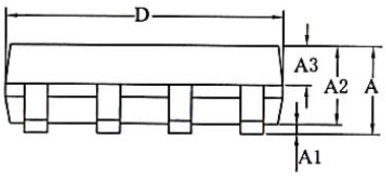
SOP8 外形尺寸

封装尺寸

SYMBOL	MIN./mm	TYP./mm	MAX./mm
A	1.40	-	1.80
A1	0.10	-	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.38	-	0.51
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.40	0.60	0.80
L1	1.05REF		
c	0.20	-	0.25
θ	0°	-	8°



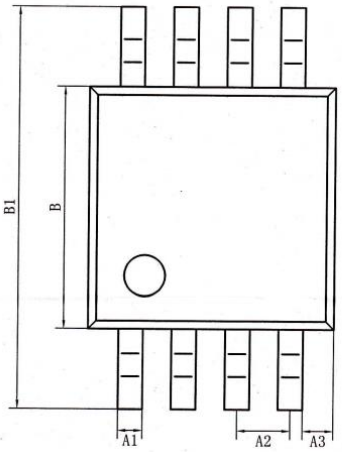


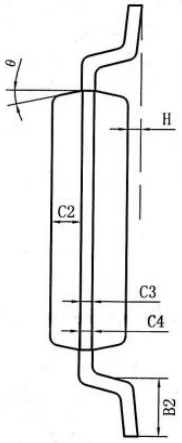


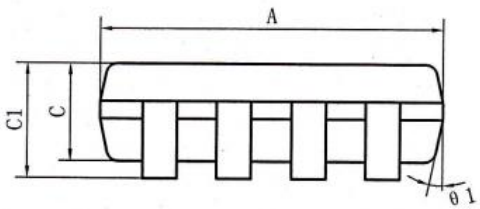
MSOP8 外形尺寸

封装尺寸

符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	2.90	3.0	3.10
A1	0.28		0.35
A2	0.65TYP		
A3	0.375TYP		
B	2.90	3.0	3.10
B1	4.70		5.10
B2	0.45		0.75
C	0.75		0.95
C1			1.10
C2	0.328 TYP		
C3	0.152		
C4	0.15		0.23
H	0.00		0.09
θ	12°TYP		



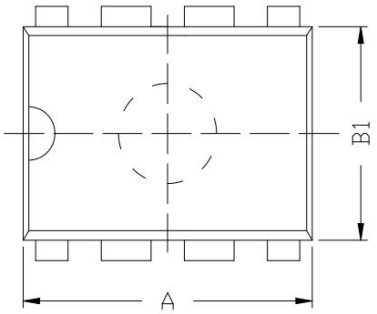


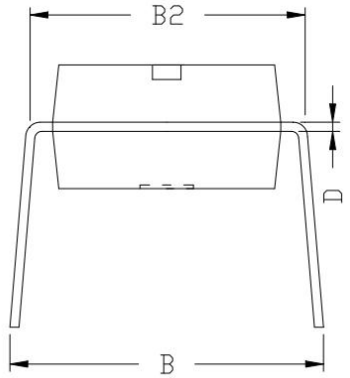


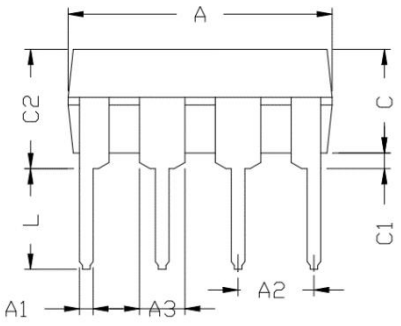
DIP8 外形尺寸

封装尺寸

符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	9.00	9.20	9.40
A1	0.33	0.45	0.51
A2	2.54TYP		
A3	1.525TYP		
B	8.40	8.70	9.10
B1	6.20	6.40	6.60
B2	7.32	7.62	7.92
C	3.20	3.40	3.60
C1	0.50	0.60	0.80
C2	3.71	4.00	4.31
D	0.20	0.28	0.36
L	3.00	3.30	3.60



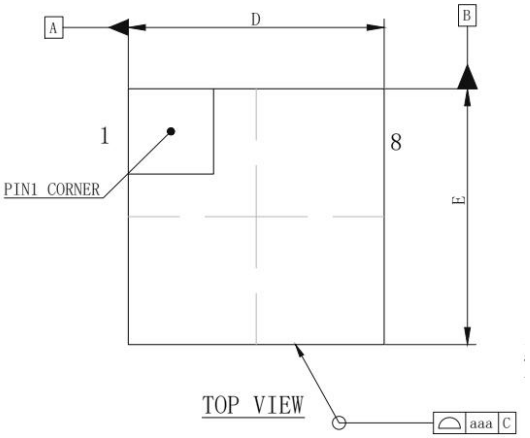


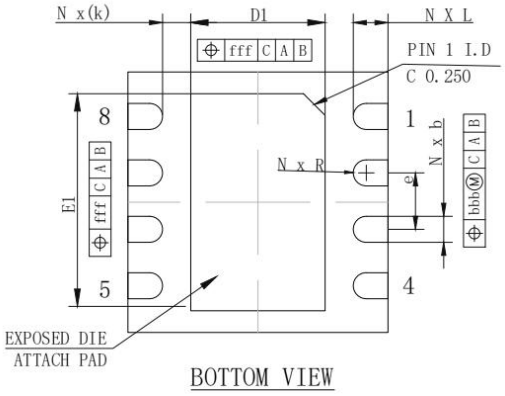


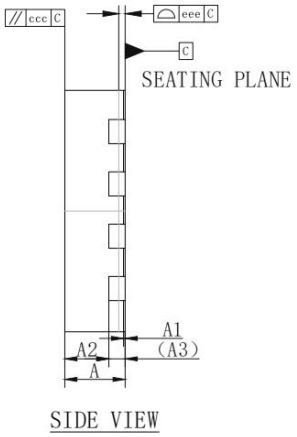
DFN3*3-8 外形尺寸

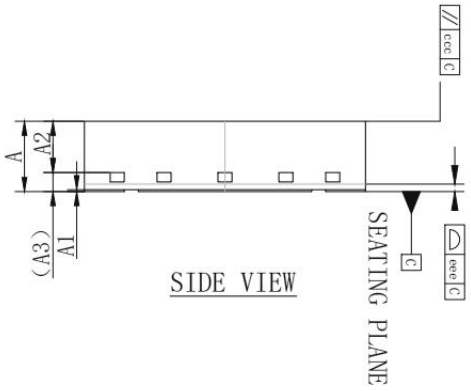
封装尺寸

符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
D	2.900	3.000	3.100
E	2.900	3.000	3.100
D1	1.450	1.550	1.650
E1	2.400	2.500	2.600
A	0.700	0.750	0.800
A1	0.000	0.020	0.050
A2	0.497	0.547	0.597
A3	0.203 REF		
b	0.250	0.300	0.350
e	0.65 BSC		
k	0.325 REF		
L	0.350	0.400	0.450
aaa	0.100		
ccc	0.100		
eee	0.080		
bbb	0.070		
fff	0.100		

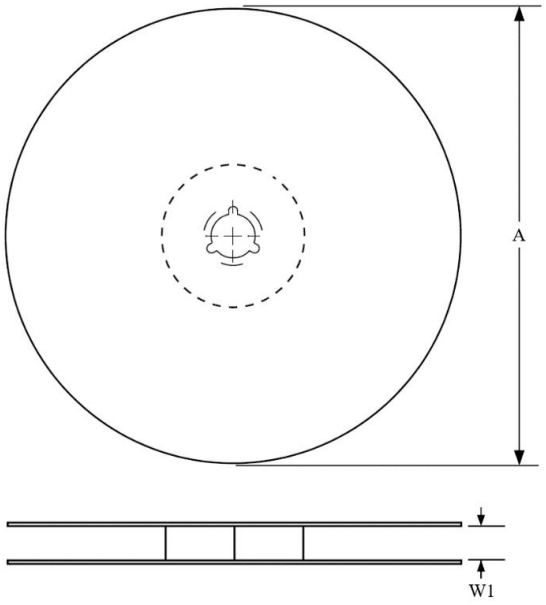




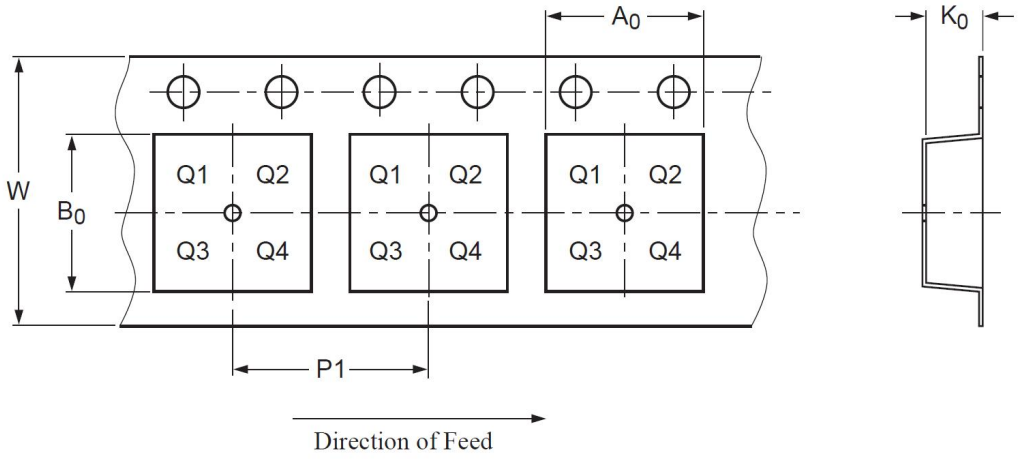




编带信息



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers



PIN1 is in quadrant 1

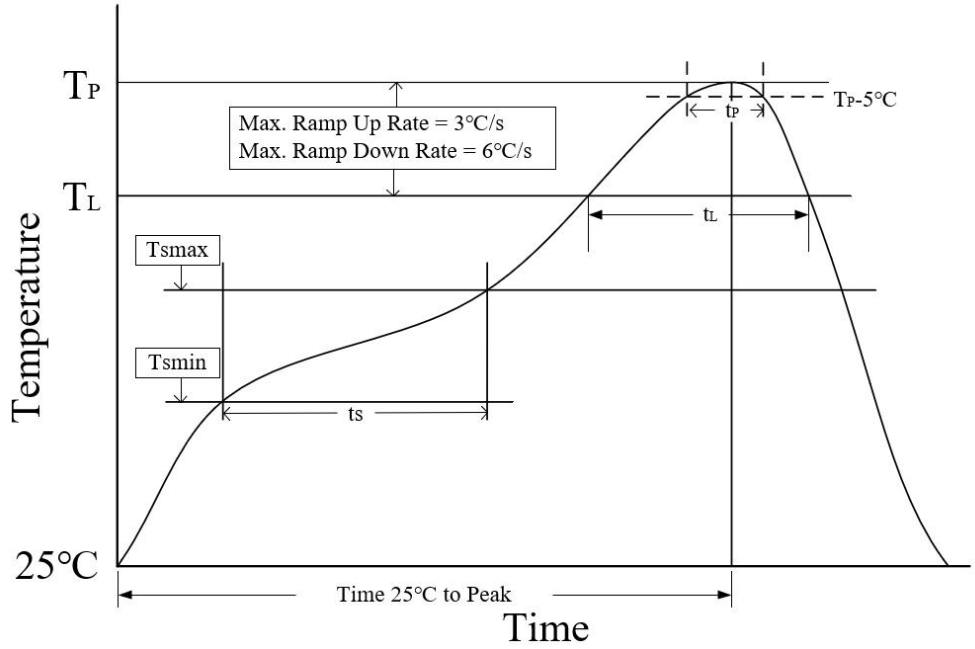
封装类型	卷盘直径 A (mm)	编带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)
SOP8	330	12.5±0.20	6.50±0.1	5.30±0.10	2.05±0.1	8.00±0.1	12.00±0.1
MSOP8	330	12.5±0.20	5.33±0.10	3.40±0.10	1.53±0.10	8.00±0.10	$12.00^{+0.30}_{-0.10}$
DFN3*3-8	330	12.5±0.20	3.30±0.10	3.30±0.10	1.10±0.1	8.00±0.10	$12.00^{+0.30}_{-0.10}$

定购信息

定购代码	封装	包装方式
SIT3088EESA	SOP8	盘装编带
SIT3088EEUA	MSOP8	盘装编带
SIT3088ETK	DFN3*3-8， 小外形，无引脚	盘装编带
SIT3088EEPA	DIP8	管状包装

编带式包装为 2500 颗/盘，DFN3*3-8，小外形，无引脚封装为 5000 颗/盘。管状包装为 50 颗/管。

回流焊



参数	无铅焊接条件
平均温升速率（T_L to T_P）	3 °C/second max
预热时间 ts（T_{smin}=150 °C to T_{smax}=200 °C）	60-120 seconds
融锡时间 t_L（T_L=217 °C）	60-150 seconds
峰值温度 T_P	260-265 °C
小于峰值温度 5 °C以内时间 t_P	30 seconds
平均降温速率（T_P to T_L）	6 °C/second max
常温 25°C 到峰值温度 T_P 时间	8 minutes max

重要声明

芯力特有权在不事先通知的情况下，保留更改上述资料的权利。

修订历史

版本号	修订内容	修订时间
V1.0	初始版本。	2020.01
V1.1	格式调整。	2020.01
V1.2	格式调整。	2020.02
V1.3	删除连续功耗相关参数； 增加 DFN3*3-8 相关信息。	2020.03
V1.4	增加 DFN3*3-8 订购数量。	2020.04
V1.5	更新 t_{DD}、t_{TD}、t_{PLH}、t_{PHL}、t_{PDS} 测试条件。	2020.08
V1.6	更新 SOP8 和 DFN3*3-8 封装信息； 增加“重要声明”。	2022.01
V1.7	增加编带信息； 增加回流焊信息； 增加修订历史。	2022.11
V1.8	更新测试示意图；	2022.12
V1.9	修改外观尺寸参数及示意图； 删除 8μMAX、VSSOP8 相关信息。	2026.10